

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：492616

[44]中華民國 91 年 (2002) 06 月 21 日

新型

全 6 頁

[51] Int.Cl.⁰⁷ : H05K7/00
H01L21/68

[54]名 稱：IC 承載盤識別裝置

[21]申請案號：089211263

[22]申請日期：中華民國 89 年 (2000) 06 月 30 日

[72]創作人：

黃琮琳

高雄縣仁武鄉水管路九十七號

[71]申請人：

樺塑企業股份有限公司

高雄縣仁武鄉水管路九十七號

[74]代理人：詹景堯 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

1. 一種 IC 承置盤識別裝置，該 IC 承置盤二相對側邊設有上、下交錯排列狀的上凸緣及下凸緣，其特徵在於，可以一識別卡嵌套於上、下凸緣處，該識別卡為長條狀片體，其下側中央設有一凸片，並在前側端面近右側適當處設一凸起的扳片，且前側端面處設有 IC 規格之標示者。
2. 一種 IC 承置盤識別裝置，該 IC 承置盤二相對側邊設有上、下交錯排列狀的上凸緣及下凸緣，其特徵在於，可以一識別卡嵌套於上、下凸緣處，該識別卡為長條狀片體，其上側中央設有一凹槽，並在前側端面凹槽的側邊處設一凸起的扳片，且前側端面處設有 IC 規格之標示者。
3. 如申請專利第 1 項所述 IC 承置盤識別裝置，其中在識別卡之凸片靠近扳

片下方處開設一貫穿之長槽者。

4. 如申請專利第 2 項所述 IC 承置盤識別裝置，其中於識別卡左側邊較高之端角處開設有貫穿之長槽者。
5. 5. 如申請專利第 1 或 2 項所述 IC 承置盤識別裝置，其中在識別卡端面設立之標示，係可為塗佈色彩，或書寫文字，或為色彩及文字之組合，或為其他足以表示之方式者。

10. 圖式簡單說明：

圖一係習用 IC 承置盤之立體圖。

圖二係習用 IC 承置盤疊置及標示之示意圖。

15. 圖三係本創作一較佳實施例之立體圖。

圖四係圖三嵌卡前之示意圖。

圖五係圖三嵌卡後之示意圖。

圖六係圖三之實施例圖。

20. 圖七係本創作另一較佳實施例之立體圖。

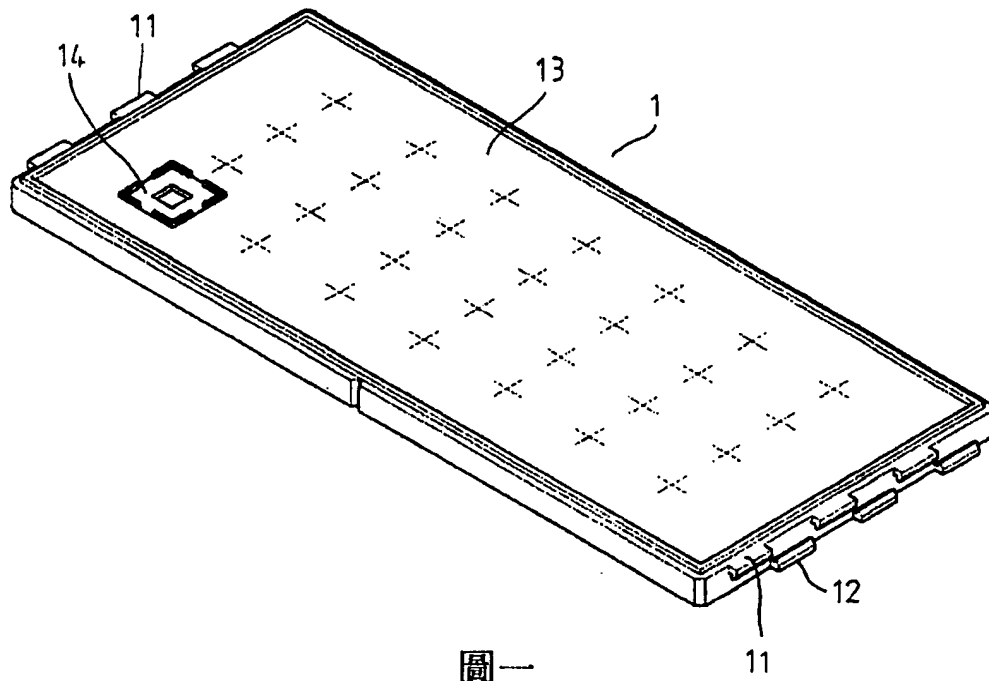
(2)

3

4

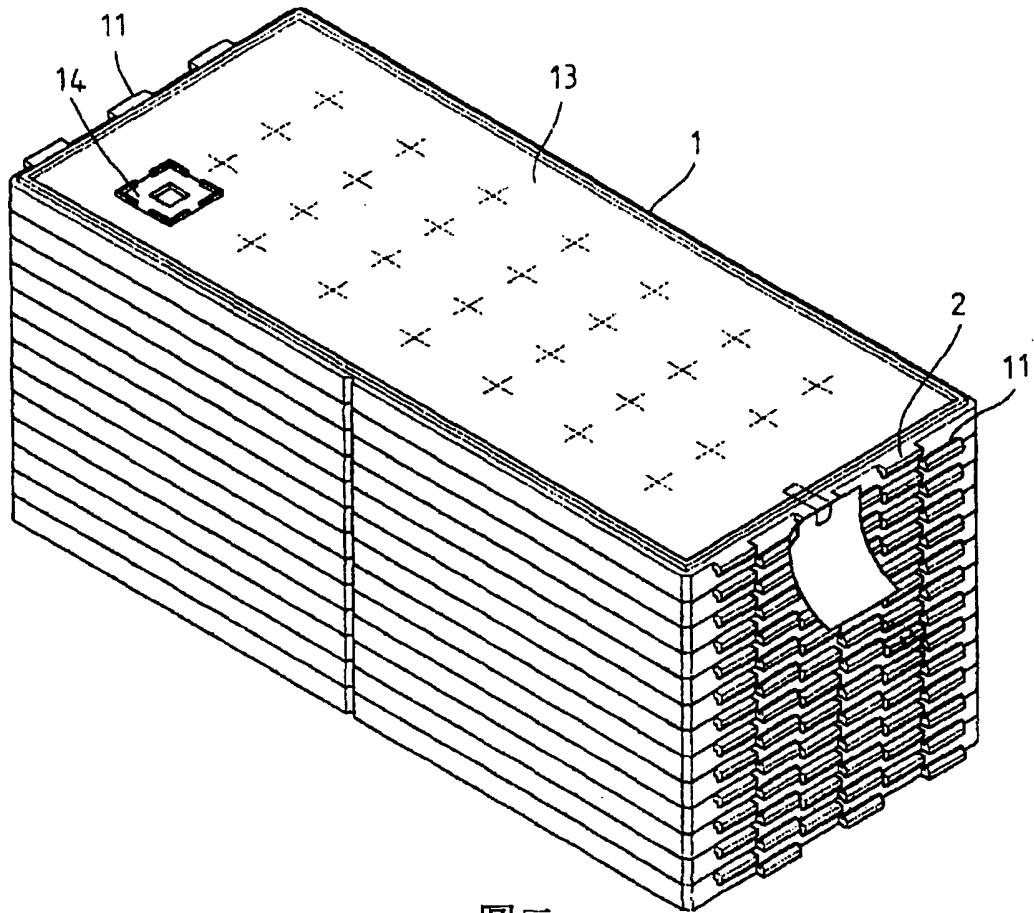
圖八係圖七嵌卡前之示意圖。
圖九係圖七嵌卡後之示意圖。

圖十係圖七之實施例圖。

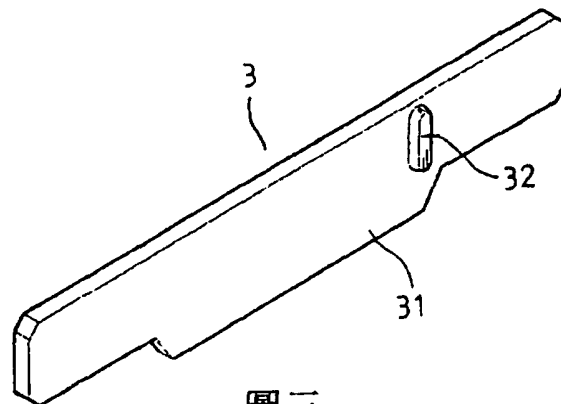


圖一

(3)

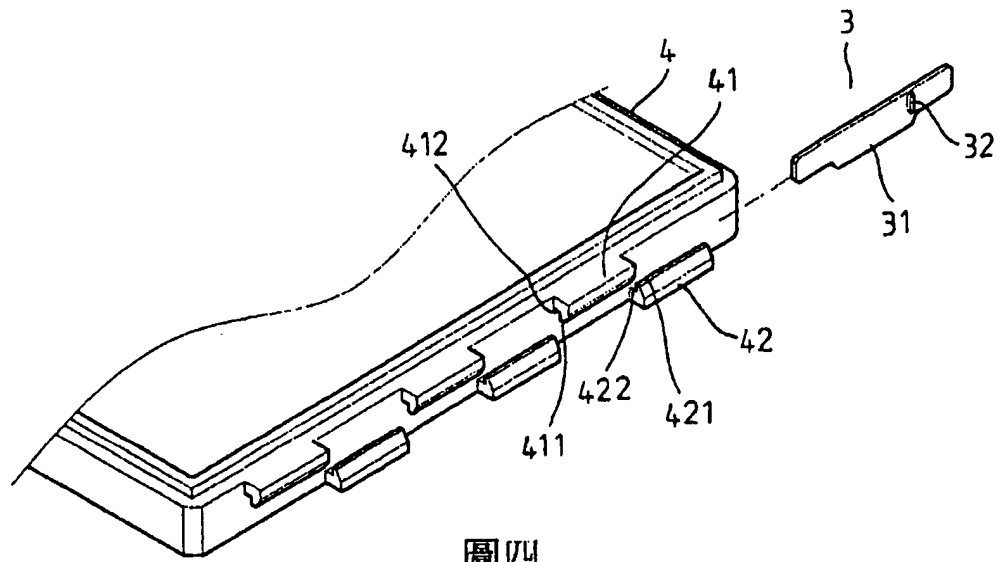


圖二

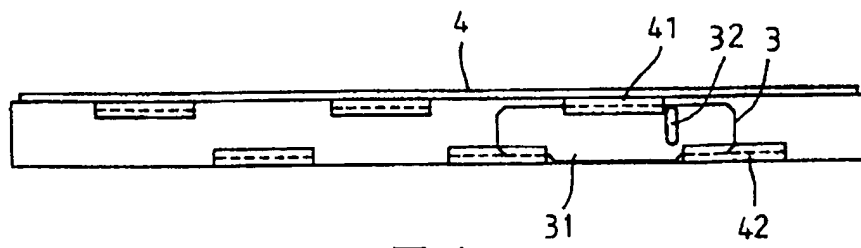


圖三

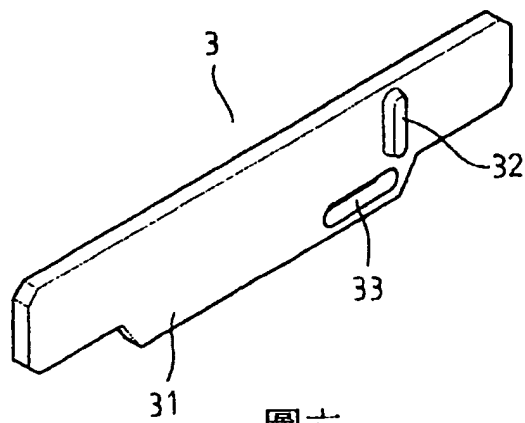
(4)



圖四

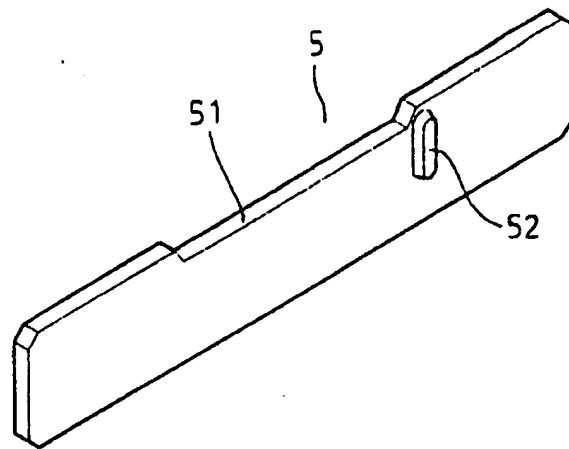


圖五

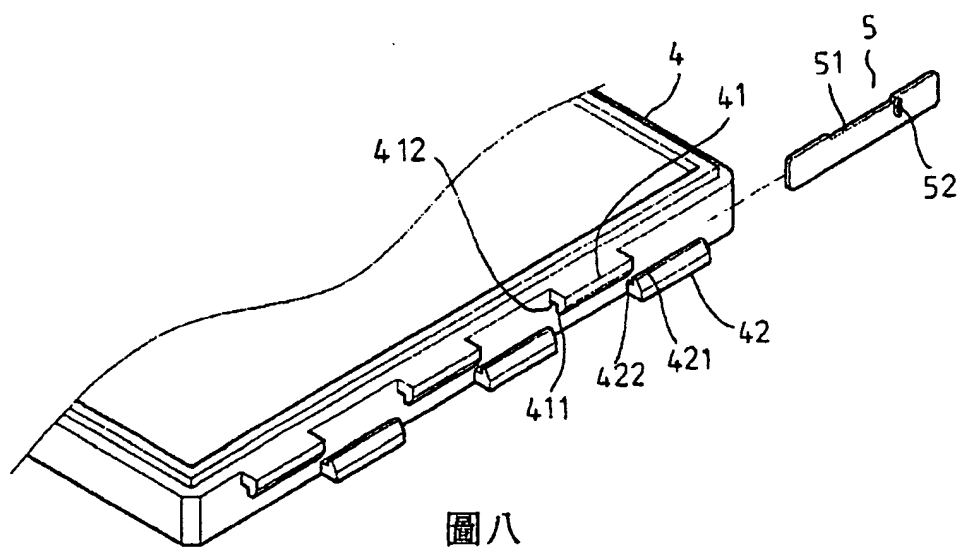


圖六

(5)

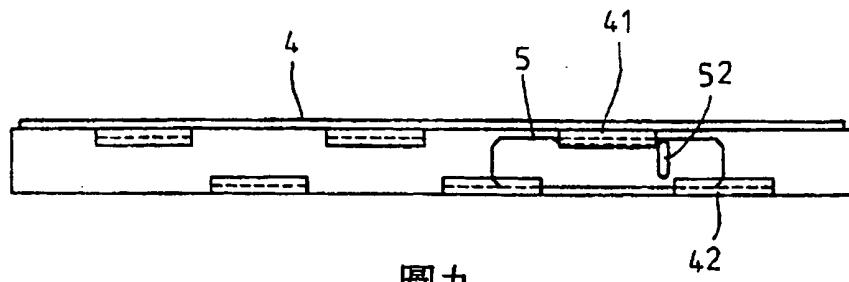


圖七

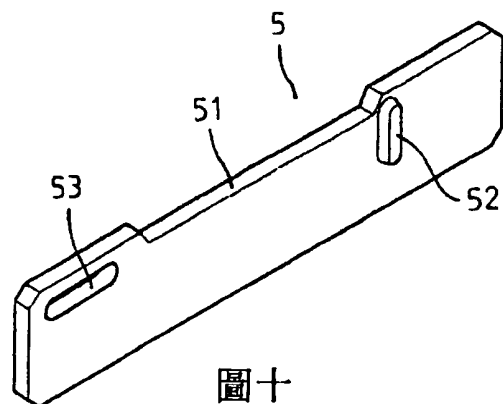


圖八

(6)



圖九



圖十